2027集成电路(无锡)产品与装备博览会

国际半导体设备与核心部件·材料(无锡)展览会

2027 Integrated Circuit (Wuxi) Products and Equipment Expo · International Semiconductor Equipment, Core Components, and Materials (Wuxi) Exhibition

观展时间 TIME

2027.06.24-26

观展地点 ADD

无锡太湖国际博览中心
无锡国际会议中心

10万㎡ 十大馆!

2027 集成电路（无锡）创新发展大会暨集成电路（无锡）产品与装备博览会
定档无锡6月24日开幕

一场千人峰会+10大论坛!

长三角半导体产业链年度大展
6月无锡启幕

设备、制造、设计、封测全链条覆盖

2027 集成电路（无锡）创新发展大会暨集成电路（无锡）产品与装备博览会
招商展览正式启动

协会+龙头企业合力打造

2027 集成电路（无锡）创新发展大会暨集成电路（无锡）产品与装备博览会
6月见

GLOBAL CALL FOR EXHIBITORS

全球招商邀请函

▸ 聚力核心装备材料·筑牢集成电路产业根基



2027集成电路(无锡)产品与装备博览会

国际半导体设备与核心部件·材料(无锡)展览会

2027 Integrated Circuit (Wuxi) Products and Equipment Expo · International Semiconductor Equipment, Core Components, and Materials (Wuxi) Exhibition

聚力核心装备材料
筑牢集成电路产业根基

尊敬的半导体、集成电路产业链各企事业单位、科研院所、行业协会及产业同仁：

集成电路是数字经济的基石，半导体设备、核心材料与关键零部件，是实现产业链自主安全可控的攻坚高地。无锡作为国内集成电路产业重镇，产业基础雄厚，晶圆制造、先进封测、配套企业高度集聚，长三角上下游市场需求旺盛。为落实产业强链补链延链，打通“设备—材料—零部件—工艺—检测”供需通道，由龙头企业、行业学会协会多方合力打造的2027 集成电路 (无锡) 创新发展大会国际半导体设备核心部件·材料(无锡)展览会，定于2027年6月24-26日，在无锡太湖国际博览中心+无锡国际会议中心盛大启幕。组委会诚挚邀请海内外企业参展参会，共赴长三角“芯”盛会！

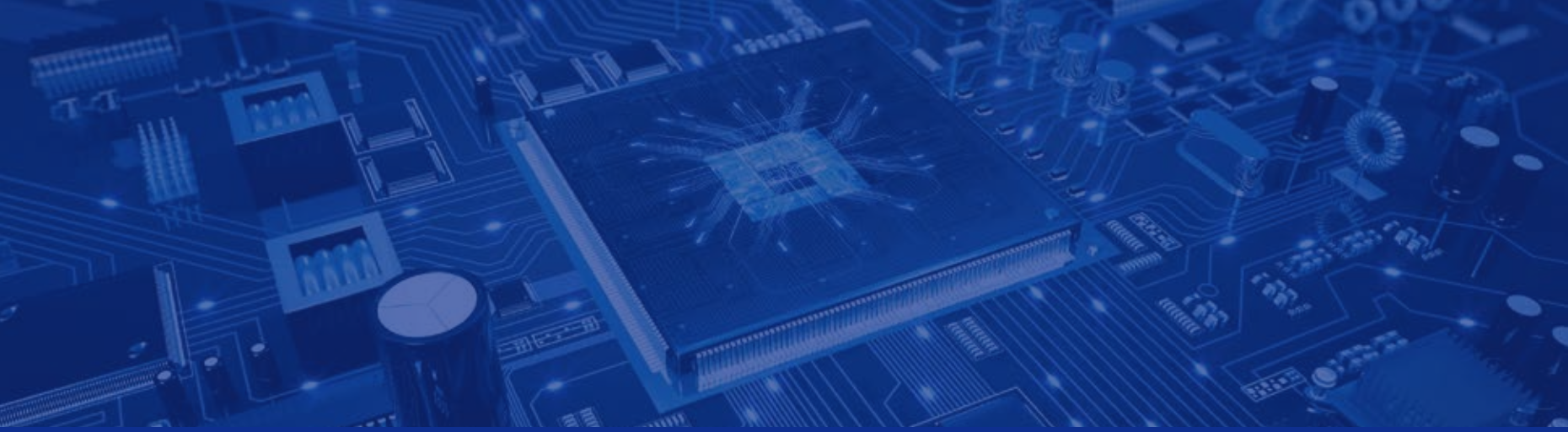
Dear enterprises, public institutions, research institutes, industry associations and peers across the semiconductor and integrated-circuit industrial chain,

Integrated circuits constitute the cornerstone of the digital economy. Semiconductor equipment, core materials and key components are the critical frontiers for achieving self-reliance, security and controllability of the industrial chain.

As a key hub of China's integrated-circuit industry, Wuxi boasts a solid industrial foundation, home to a high concentration of wafer fabrication, advanced packaging & testing and supporting-service enterprises, with robust upstream-downstream market demand within the Yangtze River Delta.

To strengthen, supplement and extend the industrial chain and build a supply-demand channel covering “equipment-materials-components-process-testing”, the 2027 Integrated Circuit (Wuxi) Products and Equipment Expo · International Semiconductor Equipment, Core Components, and Materials (Wuxi) Exhibition, jointly organised by leading enterprises, industry societies and associations, will be grandly held from June 24-26, 2027 at Wuxi Taihu International Expo Center and Wuxi International Conference Center.

The Organising Committee sincerely invites domestic and overseas enterprises to exhibit and attend this event, and gather for this grand “chip-themed” gala of the Yangtze River Delta!



Scale & Event Portfolio

规模与活动矩阵

同期活动

- 千人半导体产业主题峰会
- 十大细分专业论坛
- 晶圆厂与封测厂供需对接会
- 新品技术发布会、成果转化路演、园区招商推介、产业政策解读沙龙

专业观众覆盖

- 晶圆制造 · 先进封测 · 设备整机
- 核心材料 · 零部件 · 检测机构
- 高校科研 · 产业园区 · 投融资机构
- 供应链采购及海外采购代表团

注 : 展会规模及同期活动以组委会最终公布为准。



无锡作为全国集成电路产业集聚度最高、产业链最完整的城市之一，封测产业全国领先、晶圆制造基础雄厚、设备零部件配套体系完善，正加速从“产业规模大市”向“产业能级强市”跨越。

基于此，本次全新策划展会立足无锡产业禀赋、紧扣省市工信产业发展部署，聚焦全产业链生态构建、应用场景反向牵引、头部资源集聚落地、产学研用深度转化，打造层级更高、链条更全、落地性更强的集成电路顶级生态盛会，助力无锡抢占产业新赛道、巩固全国产业标杆地位，为全市集成电路产业高质量发展、产业链强链补链延链提供核心平台支撑。

立足**产业**·链接**市场**·把握**商机**

精研芯造·智启未来

聚力核心装备材料，筑牢集成电路产业根基



1 SCHEDULE 日程安排

- 布展时间：2027 年 06 月 22 日 - 23日
- 展览时间：2027 年 06 月 24 日 - 26日
- 撤展时间：2027 年 06 月 26 日

2 MEETING EVENTS 会议活动安排

- 千人半导体产业主题峰会
- 十大细分专业论坛
- 晶圆厂与封测厂供需对接会
- 新品技术发布会、成果转化路演、园区招商推介

3 SERVICE 服务项目

办理展品运输及留购，提供优惠住宿、旅游；代订回程飞机票、火车票，费用自理。

免费向专业人士提供《展品预览》及时架起供需双方的桥梁。

免费提供参观券供展商邀请客户使用；展场定期清洁及24小时保卫。

4 PROCEDURE 参展程序

凡符合展览范围的企业，均可申请参展。贵单位如报名参展，请认真填写参展申请表，加盖公章后扫描或邮寄至组委会；
申请展位5日内按以下帐号将参展费用电汇或交至组织单位；

展位顺序分配原则：“先申请、先付款、先安排”
参展商在汇出费用后，请将银行汇款底单发送至组委会。

5 COST 参展费用

1、国际标准展位——32000元人民币/个展位

9㎡ 起订，包括：空白背墙、楣板、咨询桌、椅子、射灯、220V/5A电源插座、地毯，需自行制作展板画面。

2、展览空场地——3000元人民币/平方米

36㎡ 起订，自行设计搭建特装。

享受权益：

·公司LOGO以支持单位名义出现在对外宣传物料上
·标摊展桌前统一贴KT板画面(主办方制作，画面默认为展商logo+大会logo)

ADVERTISING

6 广告费用

会刊广告

统一采用电子会刊，高清三色图文排版，完整收录展会详情、参展企业、展品供需等行业资料，作为线上品牌宣传、商贸对接、信息查阅的数字化专业媒介。

封面：20000元　封底：16000元　黑白整版：2000元
封二：12000元　封三：10000元　彩页：6000元
参观券：20000元/万张

其它广告

高炮广告二分之一面：10000元/月
广场桁架广告：20000元/块
论坛区广告费：12000元



CONTENT

7 展会内容

晶圆制造设备

晶圆全流程前道工艺设备；光刻、刻蚀、薄膜沉积（CVD/PVD/ALD）、离子注入、热处理、化学机械抛光CMP、清洗设备、晶圆传输设备；量检测设备（缺陷检测、膜厚测量、电子扫描电镜）；晶圆厂配套工艺设备、自动化控制系统、洁净工艺装备；设备改造、维保、零部件配套服务。

封测设备

传统封装设备、先进封装专用设备（2.5D/3D、Chiplet、HBM、晶圆级封装）；划片、研磨减薄、键合、塑封、植球设备；半导体测试设备：ATE测试系统、探针台、分选机；X-Ray、超声扫描等无损检测设备；封测产线自动化、智能制造解决方案、设备升级运维服务。

半导体核心部件

半导体设备精密核心零部件；真空系统、真空泵、射频电源、静电吸盘、高纯阀门、流体控制系统；精密传动模组、晶圆机械手、光学元器件、传感器、精密陶瓷件、密封件；冷却系统、离子源、流量计；设备子系统、零部件加工、精密机械加工服务。

半导体关键材料

硅片、碳化硅/氮化镓等第三代半导体衬底；光刻胶、光掩模版、电子特种气体、高纯湿电子化学品；靶材、抛光液/抛光垫；封装材料：引线框架、键合丝、封装基板、塑封料、底部填充胶；特种功能薄膜、石英制品；材料分析检测服务。

芯片设计专区

各类集成电路设计企业；AI算力芯片、存储芯片、汽车芯片、功率芯片、射频芯片、MCU、传感器芯片；EDA设计软件、半导体IP核；RISC-V架构生态；设计服务、芯片验证、仿真测试、知识产权服务；芯片安全解决方案。

封装产业与先进技术

各类封测代工企业、先进封装方案商；Fan-out、CoWoS、TSV、玻璃基板封装等前沿封装技术；系统级封装SiP；封装工艺研发；封装基板产业链；封测材料配套；失效分析、可靠性测试服务；封测智能制造整体方案。

芯片制造与产业配套

晶圆代工（Foundry）企业、特色工艺产线；化合物半导体制造；半导体厂房工程、洁净室系统、高纯供气供水系统；产业配套：检测认证、科研院所成果转化、投融资机构、行业协会、媒体；下游应用展示：汽车电子、工控、人工智能、医疗电子等芯片落地应用场景。



8 HIGHLIGHTS 展会优势

- **规模大：** 十大展馆、十万平米大展，会议中心同步承载千人峰会和十大论坛，展览 + 会议一体化布局，产业人群集中到访。
- **区位好：** 立足无锡，辐射上海、苏州、南京、合肥、宁波等长三角芯片产业集群，直面大量一线采购资源。
- **买家专：** 组委会联合协会、园区定向邀约产线采购、工艺、设备、供应链负责人； 专场对接会提高商务匹配效率。
- **平台高：** 协会、龙头企业共同背书，政策、技术、产业、资本多方资源汇聚。
- **性价比优：** 相较于一线城市大展，展位、搭建、差旅综合成本更低，是企业拓展华东市场、做品牌展示、寻找配套客户的高效平台。

CORE HIGHLIGHT

9 展会核心亮点

不止于展 更重于“链”

技术成果路演台

1 每日邀请企业首席科学家 / 技术总监进行 15-20 分钟创新成果发布，现场开放技术问答，直击行业痛点，提升展商技术声量。

产业链协同对接廊

2 专属区域串联设计、制造、封测、应用各环节，设置“需求挂牌墙”与“一对一洽谈区”，提前收集供需信息，安排精准匹配，助您快速找到上下游合作伙伴。

场景化体验区

3 模拟汽车电子、智能工厂、数据中心等真实应用场景，让您的产品“可见、可感、可验证”，直观展现技术优势。

轻量高端，精准邀约

4 严格控制非目标观众，定向邀请晶圆厂、封测厂、IDM 企业、整车厂、AI 算力企业的采购与技术决策层，拒绝“赶集式”人流，确保每一次交流都有含金量。



DUAL VENUES

10 双会场联动

Wuxi Taihu International Expo Center

无锡太湖国际博览中心











WUXI INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER

无锡国际会议中心













场馆实际使用区域及交通指引，以组委会最终发布信息为准。

诚邀相聚无锡·共拓芯机遇

2027.06.24-26

大会组委会：

李刚：18222 90 1822 (同V)

邮箱：hzlb518@sina.com